



## 2019年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2018年10月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2018年11月13日

配当支払開始予定日

2018年11月26日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2019年3月期第2四半期の連結業績(2018年4月1日～2018年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年3月期第2四半期	691,034	33.7	175,418	42.2	181,247	47.3	135,294	49.2
2018年3月期第2四半期	516,976	46.6	123,318	105.5	123,066	97.3	90,668	116.1

(注) 包括利益 2019年3月期第2四半期 136,416百万円 (40.9%) 2018年3月期第2四半期 96,850百万円 (196.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2019年3月期第2四半期	824.70	821.27
2018年3月期第2四半期	552.59	550.74

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年3月期第2四半期	1,238,513	849,595	68.0
2018年3月期	1,202,796	771,509	63.8

(参考) 自己資本 2019年3月期第2四半期 842,044百万円 2018年3月期 767,146百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2018年3月期		277.00		347.00	624.00
2019年3月期		413.00			
2019年3月期(予想)				311.00	724.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 2019年3月期の連結業績予想(2018年4月1日～2019年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,280,000	13.2	309,000	9.9	315,000	12.2	237,000	16.0	1,445.20

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

## 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2019年3月期2Q	165,210,911 株	2018年3月期	165,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2019年3月期2Q	1,281,938 株	2018年3月期	1,097,342 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2019年3月期2Q	164,054,351 株	2018年3月期2Q	164,078,737 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2019年3月期2Q 252,300株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

### 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2018年10月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(追加情報)	10
(セグメント情報等)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間につきましては、米国経済は引き続き好調であり、また、アジアや欧州経済は緩やかな回復を続けるなど、世界経済全体につきましては、概ね堅調に推移しました。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、半導体メモリの価格調整がみられたものの、データセンター向け半導体の需要は引き続き活発であり、半導体・電子部品の市況は堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社グループの当第2四半期連結累計期間の連結業績は、売上高6,910億3千4百万円(前年同期比33.7%増)、営業利益1,754億1千8百万円(前年同期比42.2%増)、経常利益1,812億4千7百万円(前年同期比47.3%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,352億9千4百万円(前年同期比49.2%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

## ① 半導体製造装置

DRAM、3次元構造のNANDフラッシュメモリ、ロジック系半導体向けの設備投資においてモバイル向けに加え、旺盛なデータセンター向け需要を背景に半導体メーカーの設備投資は継続的に行われ、半導体製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、6,384億5千7百万円(前年同期比30.9%増)となりました。

## ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

中国においてテレビ用大型液晶パネル向けの需要が活発化したことによる設備投資の増加に加え、スマートフォン用中小型有機ELパネル向けの設備投資も継続し、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、524億6千8百万円(前年同期比80.8%増)となりました。

## ③ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億8百万円(前年同期比48.0%減)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	516,976	613,751	691,034	395,465
半導体製造装置	487,743	567,490	638,457	358,057
日本	65,244	80,263	109,195	58,048
北米	56,174	63,068	74,406	45,910
欧州	52,314	44,626	49,101	31,345
韓国	170,165	201,780	175,545	86,558
台湾	82,543	86,519	74,372	48,057
中国	49,830	54,491	126,270	71,306
東南アジア他	11,469	36,740	29,564	16,830
F P D製造装置	29,024	46,044	52,468	37,354
その他	208	216	108	53
営業利益	123,318	157,854	175,418	103,000
経常利益	123,066	157,671	181,247	106,034
親会社株主に帰属する 四半期純利益	90,668	113,702	135,294	79,553

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ193億9千3百万円増加し、9,659億9千万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の増加465億円、現金及び預金の増加34億8百万円、未収消費税等の減少288億3千6百万円、受取手形及び売掛金の減少41億8千6百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から139億4千8百万円増加し、1,399億1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から12億5千万円増加し、171億3千2百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から11億2千4百万円増加し、1,154億8千9百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から357億1千6百万円増加し、1兆2,385億1千3百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ433億8千9百万円減少し、3,250億6千3百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少257億2千1百万円、未払法人税等の減少196億9千7百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ10億2千万円増加し、638億5千5百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ780億8千5百万円増加し、8,495億9千5百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,352億9千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当569億4千7百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は68.0%となりました。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、上記の前期末比較については、当該会計基準等を遡って適用した後の前連結会計年度の数値で比較しております。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ214億8百万円増加し、2,792億8千6百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,445億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ499億8百万円増加し、4,237億8千6百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ675億7千3百万円増加の1,355億2千1百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益1,811億3百万円、未収消費税等の減少288億6千1百万円、減価償却費107億1千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額635億8千万円、仕入債務の減少265億3千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の増加による支出285億円、有形固定資産の取得による支出223億3千万円により、前年同期の312億7千2百万円の収入に対し529億8百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払569億4千7百万円、自己株式の取得による支出50億1百万円により、前年同期の368億2百万円の支出に対し619億5千万円の支出となりました。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

半導体市場につきましては、人工知能(AI)、次世代通信規格などの新技術による半導体需要を背景に中長期での市場の成長は引き続き見込まれ、2018年5月29日に発表した中期経営計画の目標に変更はありません。しかしながら、2019年3月期の連結業績につきましては、半導体メーカーによる設備投資計画の調整が見受けられることを踏まえ、2018年4月25日に公表した通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

## 2019年3月期の連結業績予想

	通 期
売上高	1兆2,800億円(前期比 13.2%増)
半導体製造装置	1兆1,698億円(前期比 10.9%増)
F P D 製造装置	1,100億円(前期比 46.5%増)
営業利益	3,090億円(前期比 9.9%増)
経常利益	3,150億円(前期比 12.2%増)
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,370億円(前期比 16.0%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	87,377	90,786
受取手形及び売掛金	159,570	155,384
有価証券	286,500	333,000
商品及び製品	220,497	226,711
仕掛品	75,504	62,373
原材料及び貯蔵品	48,069	55,010
その他	69,137	42,813
貸倒引当金	△59	△87
流動資産合計	946,597	965,990
固定資産		
有形固定資産	125,952	139,901
無形固定資産		
その他	15,882	17,132
無形固定資産合計	15,882	17,132
投資その他の資産		
その他	115,786	116,936
貸倒引当金	△1,422	△1,447
投資その他の資産合計	114,364	115,489
固定資産合計	256,199	272,522
資産合計	1,202,796	1,238,513

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	108,607	82,885
未払法人税等	66,046	46,348
前受金	100,208	98,134
賞与引当金	34,467	34,312
製品保証引当金	11,284	14,357
その他の引当金	4,618	2,619
その他	43,218	46,404
流動負債合計	368,452	325,063
固定負債		
その他の引当金	374	981
退職給付に係る負債	59,309	59,821
その他	3,150	3,052
固定負債合計	62,834	63,855
負債合計	431,287	388,918
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	625,390	703,704
自己株式	△7,518	△12,055
株主資本合計	750,843	824,620
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17,134	13,481
繰延ヘッジ損益	278	△182
為替換算調整勘定	5,507	9,744
退職給付に係る調整累計額	△6,618	△5,619
その他の包括利益累計額合計	16,302	17,423
新株予約権	4,363	7,550
純資産合計	771,509	849,595
負債純資産合計	1,202,796	1,238,513



## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
売上高	516,976	691,034
売上原価	301,561	406,925
売上総利益	215,415	284,109
販売費及び一般管理費		
研究開発費	46,062	57,338
その他	46,034	51,352
販売費及び一般管理費合計	92,097	108,691
営業利益	123,318	175,418
営業外収益		
受取配当金	282	1,744
為替差益	—	1,885
その他	1,380	2,308
営業外収益合計	1,663	5,938
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	38	33
為替差損	1,769	—
その他	107	75
営業外費用合計	1,915	109
経常利益	123,066	181,247
特別利益		
固定資産売却益	73	2
特別利益合計	73	2
特別損失		
固定資産除売却損	292	146
投資有価証券評価損	536	—
特別損失合計	829	146
税金等調整前四半期純利益	122,311	181,103
法人税等	31,615	45,808
四半期純利益	90,695	135,294
非支配株主に帰属する四半期純利益	27	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	90,668	135,294

四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
四半期純利益	90,695	135,294
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,550	△3,648
繰延ヘッジ損益	△181	△422
為替換算調整勘定	3,229	4,188
退職給付に係る調整額	△404	970
持分法適用会社に対する持分相当額	△38	34
その他の包括利益合計	6,155	1,121
四半期包括利益	96,850	136,416
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	96,822	136,416
非支配株主に係る四半期包括利益	28	—

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	122,311	181,103
減価償却費	9,025	10,718
のれん償却額	325	266
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	1,554	3,037
受取利息及び受取配当金	△604	△2,014
売上債権の増減額 (△は増加)	△8,209	5,592
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△44,824	1,426
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,645	△26,535
未収消費税等の増減額 (△は増加)	16,474	28,861
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△1,230	△1,204
前受金の増減額 (△は減少)	△4,742	△2,310
その他	4,746	△1,935
小計	97,470	197,006
利息及び配当金の受取額	715	2,094
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△30,238	△63,580
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,947	135,521
投資活動によるキャッシュ・フロー		
短期投資の増減額 (△は増加)	50,000	△28,500
有形固定資産の取得による支出	△16,677	△22,330
無形固定資産の取得による支出	△2,163	△862
その他	113	△1,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,272	△52,908
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△3	△5,001
配当金の支払額	△36,752	△56,947
その他	△45	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,802	△61,950
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,145	746
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	64,563	21,408
現金及び現金同等物の期首残高	164,366	257,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	228,930	279,286

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(追加情報)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	638,457	52,468	9,659	700,586	△9,551	691,034
セグメント利益 又は損失(△)	184,225	11,967	△64	196,127	△15,024	181,103

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△15,024百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△8,070百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。